

一般社団法人溶接学会 マイクロ接合研究委員会
歴代受賞者リスト

マイクロ接合功績賞

受賞年	受賞年	受賞者	所属
1996年度	平成8年度	片山茂	元 日本電気(株)
1996年度	平成8年度	仲田周次	大阪大学
1996年度	平成8年度	田中政直	元 石福金属工業(株)
1996年度	平成8年度	日置進	元 (株)日立製作所
1996年度	平成8年度	宮里孝典	元 精工舎
1996年度	平成8年度	青野進	元 日本アビオニクス(株)
1997年度	平成9年度	牧野光男	(株)東芝
1997年度	平成9年度	島田彌	三菱電機(株)
1997年度	平成9年度	関泰知	(株)ニコン
1997年度	平成9年度	横井和雄	富士通(株)
1998年度	平成10年度	窪田正	松下冷機(株)
1999年度	平成11年度	該当者なし	
2000年度	平成12年度	野津誠	元 松下電子工業(株)
2001年度	平成13年度	池田順治	元 松下電器産業(株)
2001年度	平成13年度	竹本正	大阪大学
2001年度	平成13年度	河野英一	元 日本電気(株)
2001年度	平成13年度	佐藤英紀	元 日本アビオニクス(株)
2001年度	平成13年度	清水俊夫	セイコープレジジョン(株)
2001年度	平成13年度	町田一道	元 三菱電機(株)
2002年度	平成14年度	該当者なし	
2003年度	平成15年度	渥美幸一郎	(株)東芝
2003年度	平成15年度	河野顕臣	(株)日立製作所
2003年度	平成15年度	齊藤亨	日鐵テクノリサーチ(株)
2004年度	平成16年度	田井英男	帝京大学 理工学部
2004年度	平成16年度	瀬尾健二	兵庫県立大学 大学院
2004年度	平成16年度	齋藤重正	富士電機機器制御(株)
2004年度	平成16年度	松村慶一	富士エクサス(株)
2005年度	平成17年度	高橋康夫	大阪大学
2005年度	平成17年度	岩見基弘	元 岡山大学
2006年度	平成18年度	該当者なし	
2007年度	平成19年度	該当者なし	
2008年度	平成20年度	該当者なし	
2009年度	平成21年度	該当者なし	
2010年度	平成22年度	佐藤武彦	大阪大学
2010年度	平成22年度	芹沢弘二	(株)日立製作所
2010年度	平成22年度	武井利泰	日本精工(株)

マイクロ接合功績賞

受賞年	受賞年	受賞者	所属
2011年度	平成23年度	藤本公三	大阪大学
2011年度	平成23年度	加柴良裕	三菱電機(株)
2011年度	平成23年度	荘司郁夫	群馬大学
2011年度	平成23年度	廣瀬明夫	大阪大学
2011年度	平成23年度	森郁夫	(株)東芝
2011年度	平成23年度	岩田剛治	大阪大学
2011年度	平成23年度	佐藤了平	大阪大学
2011年度	平成23年度	出田吾朗	三菱電機(株)
2011年度	平成23年度	加藤力弥	千住金属工業(株)
2011年度	平成23年度	弘田実保	(株)村田製作所
2011年度	平成23年度	大熊秀雄	(有)HTO
2011年度	平成23年度	荘司孝志	元 昭和電工(株)
2011年度	平成23年度	気賀智也	元 ソニーEMCS(株)
2011年度	平成23年度	鎌田信雄	化研テック(株)
2011年度	平成23年度	阪元智朗	オムロン(株)
2012年度	平成24年度	該当者なし	
2013年度	平成25年度	該当者なし	
2014年度	平成26年度	該当者なし	
2015年度	平成27年度	該当者なし	
2016年度	平成28年度	該当者なし	
2017年度	平成29年度	該当者なし	
2018年度	平成30年度	該当者なし	
2019年度	令和元年度	該当者なし	
2020年度	令和2年度	該当者なし	
2021年度	令和3年度	該当者なし	

マイクロ接合研究賞

受賞年		受賞者	所属	受賞講演
1995年度	平成7年度	田中靖久	大豊工業(株)	耐疲労性を向上させたはんだ合金の開発
1995年度	平成7年度	塚田敏彦	(株)豊田中央研究所	メニスコグラフ法における接触角測定技術の開発(2) -接触角計測システム-
1995年度	平成7年度	富岡泰造	(株)東芝	レーザーシングルポイントILB技術
1995年度	平成7年度	村田敏一	松下電器産業(株)	Pbフリーソルダの使用性能と問題点
1995年度	平成7年度	巽宏平	新日本製鐵(株)	狭ピッチボールボンディングにおけるAu-Al接合信頼性
1996年度	平成8年度	荘司郁夫	日本アイ・ビー・エム(株)	ワイヤボンダ用チップを用いた狭ピッチフリップチップアタッチ実装法
1996年度	平成8年度	森山正人	(株)本田技術研究所	電装部品におけるハンダ接合の信頼性
1997年度	平成9年度	荻谷義治	芝浦工業大学	Sn-3.5mass%Ag-X系合金ソルダの疲労特性に関する研究
1997年度	平成9年度	元山有子	(株)富士通研究所	異方導電性接着剤を用いた素子接合の接合安定性
1998年度	平成10年度	田中直敬	(株)日立製作所	吸湿による樹脂膨潤を考慮したICパッケージ接着界面のはく離発生評価
1998年度	平成10年度	落合正行	(株)富士通研究所	ディンプルプレート法による微細バンプの形成
1999年度	平成11年度	下戸直典	日本電気(株)	超多ピン半導体パッケージ用実装基板
1999年度	平成11年度	米田義之	富士通(株)	Super CSPの開発
1999年度	平成11年度	後藤友彰	富士電機(株)	シリコンとセラミックスの陽極接合技術
2000年度	平成12年度	山中浩	松下電工(株)	MID技術による射出成形立体回路を応用した微小オプトデバイスの開発
2000年度	平成12年度	成田敏男	北海道大学	Sn-Ag-Cuソルダの組織に対する組成と冷却速度の影響
2000年度	平成12年度	鳥越俊宏	日本電気(株)	レーザCVD技術と液晶表示装置への応用
2001年度	平成13年度	山根常幸	(株)東レリサーチセンター	接合界面の熱伝導現象解析
2001年度	平成13年度	赤池信一	タムラ化研(株)	鉛フリー対応水溶性耐熱ブリフックス
2002年度	平成14年度	八木能彦	松下電器産業(株)	SBB方式フリップチップ実装における導電性接着剤接合技術
2002年度	平成14年度	秋山雪治	技術研究組合 超先端電子技術開発機構	20μmピッチ微細バンプ超音波接合技術
2003年度	平成15年度	宮崎誠	長野沖電気(株)	Sn-Ag-Cu鉛フリーはんだにおけるフローはんだ付け特性に及ぼす不純物の影響
2003年度	平成15年度	藤原伸一	(株)日立製作所	Auバンプを用いた接触接続の信頼性設計技術
2003年度	平成15年度	菅謙太郎	(株)東芝	CdTe素子を用いたγ線検出器モジュールの開発
2004年度	平成16年度	吉野睦	(株)デンソー	ボンディングワイヤーのゲル中における共振のメカニズム解明と信頼性確保に関する研究
2004年度	平成16年度	今泉延弘	(株)富士通研究所	ハイエンドCMOSチップ向けアンダーフィル技術
2004年度	平成16年度	三代絹子	富士通(株)	BGAはんだ接合部のボイドが信頼性に及ぼす影響
2005年度	平成17年度	竹澤由高	(株)日立製作所	ナノ構造制御エポキシ絶縁樹脂
2005年度	平成17年度	馬場陽一郎	トヨタ自動車(株)	HVインバーター品質確保の取組み
2005年度	平成17年度	山部光治	(株)東芝	Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだの熱疲労寿命予測式の構築と低・中融点Pbフリーはんだの寿命比較
2006年度	平成18年度	粥川君治	(株)デンソー	パワーデバイス裏面電極と鉛フリーはんだの界面構造と接合性
2006年度	平成18年度	守田俊章	(株)日立製作所	半導体パッケージのはんだボール接合部に対する衝撃強度評価方法
2007年度	平成19年度	前田晃	三菱電機(株)	Sn-Ag-Cuはんだ中Au含有量が信頼性に与える影響
2007年度	平成19年度	青木雄一	エスベック(株)	はんだ接合部の熱疲労試験に及ぼす温度変化率の影響
2007年度	平成19年度	佐藤敦哉	NECシステム実装研究所	異方性導電ゴムコネクタを用いた多段積層接続技術の開発
2008年度	平成20年度	坂本善次	(株)デンソー	両面放熱パワーモジュールの実装技術
2008年度	平成20年度	林真太郎	パナソニック電工(株)	MEMSチップ実装における応力緩和構造の研究
2009年度	平成21年度	鶴田加一	千住金属工業(株)	Precoat by Powder Sheet(PPS)法による微小はんだブリコート形成技術
2009年度	平成21年度	獅子原祐樹	大阪大学	温度サイクル負荷による材料特性変化がはんだ接合部の疲労特性に及ぼす影響
2010年度	平成22年度	作山誠樹	(株)富士通研究所	低環境負荷プロセスの実現に向けた低温接合技術の開発
2010年度	平成22年度	江阪久雄	防衛大学校	Sn-Ag-Cu三元系鉛フリーはんだの凝固過程の解析
2011年度	平成23年度	佐々木陽光	(株)東芝	銀ナノ粒子を用いた高信頼性ダイボンダ技術
2011年度	平成23年度	三橋和成	(株)東レリサーチセンター	太陽電池モジュールの高分子部材の構造評価
2012年度	平成24年度	斎藤彰	(株)村田製作所	熱衝撃Snウイスカの成長に及ぼす板状のNi-Sn金属間化合物の影響
2012年度	平成24年度	澄川貴志	京都大学	超微小試験片の作製と力学実験
2013年度	平成25年度	島津武仁	東北大学	原子拡散接合法によるウエハの室温接合技術の現状と課題
2013年度	平成25年度	東平知丈	(株)日立製作所	高温対応熱電変換素子の接合技術
2014年度	平成26年度	岩本知広	茨城大学	超音波端子接合における界面現象
2015年度	平成27年度	畠山友行	富山県立大学	熱・電気連成解析を用いたパワーSi MOSFET内部の温度分布予測
2016年度	平成28年度	八甫谷明彦	(株)東芝ストレージ&デバイスソリューション社	半導体モジュール技術と分子接合技術

マイクロ接合研究賞

受賞年		受賞者	所属	受賞講演
2017年度	平成29年度	中崎義晃	(株)ナノ・キューブ・ジャパン	ナノ銅を用いたパワーデバイス向け新規導電材料
2017年度	平成29年度	谷澤秀和	サンケン電気(株)	SiC高温動作に向けたモジュール開発
2018年度	平成30年度	伊藤宏文	(株)豊田中央研究所	半導体チップとCu基板のダイボンド構造における接合材が冷熱サイクル信頼性に及ぼす影響
2018年度	平成30年度	松田朋己	大阪大学	酸化物還元反応を用いた窒化アルミニウムと金属の直接接合プロセス
2019年度	令和元年度	藤原英道	古河電気工業(株)	銅ナノペーストの活性焼結メカニズムとその応用について
2020年度	令和2年度	井上雅博	群馬大学	導電性接着剤におけるフィラー/バインダ界面の化学的相互作用と電気伝導特性発達の関係
2021年度	令和3年度	松坂壮太	千葉大学	固体イオン交換法によるガラス内金属析出物の形成とその応用

Mate優秀ポスター賞

受賞年		受賞者	所属	受賞講演
2011年度	平成24年度	喜來省吾	北海道大学	Sn-Ag-Cu-X合金の凝固中に生成するAg ₃ Snの成長に及ぼす初晶核生成頻度の影響
2011年度	平成24年度	清水悠矢	大阪大学	自己組織化実装プロセスにおける金属フィラー流動制御に関する研究
2012年度	平成25年度	馬場昭充	セーレン(株)	uDP3プロセスで形成したCu/Ni/PIフィルム界面の解析
2012年度	平成25年度	紺谷洋之	芝浦工業大学	超微細はんだ接合部の低リサイクル疲労寿命および損傷機構
2013年度	平成26年度	照井賢一郎	(株)デンソー	Sn-Cu はんだ/Cu リードフレーム接続信頼性に及ぼすNiの影響
2013年度	平成26年度	安藤宏樹	大阪大学	Sn-Bi はんだ接合部におけるエレクトロマイグレーション現象に及ぼすUBM層の効果
2014年度	平成26年度	松林良	新電元工業(株)	Agナノ粒子およびAg・Cu混合ナノ粒子ペーストのパワーデバイス接合性評価
2014年度	平成26年度	田嶋翔	芝浦工業大学	Bi少数個結晶体における双晶とすべりの協調変形
2015年度	平成27年度	松永香織	大阪大学	ダイボンディング用のAuナノポーラスシートの作製
2015年度	平成27年度	寺尾亜加梨	大阪大学	銀粒子と錫粒子の反応による接合部の化合物化と高融点化
2016年度	平成28年度	小山優	協立化学産業(株)	耐酸化性と焼結性に優れた導電性銅ペースト焼結材について
2016年度	平成28年度	白井宏明	北海道大学	金属スズ微粒子の合成と低温焼結性能
2017年度	平成29年度	林佑美	群馬大学	(001)および(111)配向銀めっき皮膜のセルフアニーリング過程における再結晶挙動
2017年度	平成29年度	中村大志	芝浦工業大学	Sn-Sb系はんだ接合部の混合モード疲労き裂進展
2018年度	平成30年度	古賀俊一	大阪大学	Cu-Mg合金から作製したCuナノポーラスシートを用いた接合部の高温放置試験
2018年度	平成30年度	中澤史穂	群馬大学	低温焼結した樹脂結合型銀マイクロペーストの微細組織評価
2019年度	令和元年度	海野陽平	群馬大学	2Dメカニカルメタマテリアル構造を利用した低周波振動発電デバイスの作製と評価
2019年度	令和元年度	西本大夢	北海道大学・住友金属鉱山(株)	アルカノールアミンで表面処理したCuナノ粒子・クラスターの合成と焼結性評価
2020年度	令和2年度	田中裕之	中越パルプ工業(株)	電子材料へのACCセルロースナノファイバーの応用
2020年度	令和2年度	大塚茜里	早稲田大学	液体有機ELを用いたオンデマンド蛍光検出システムの開発
2021年度	令和3年度	佐藤雄河	芝浦工業大学	UV硬化接着剤の硬化過程における精密部品の位置ずれ解析
2021年度	令和3年度	坂口諒	電気通信大学	マイクロソフトポンプに向けた電極作製法の検証
2021年度	令和3年度	山中佑太	群馬大学	パワー半導体用Sn-Sb-Ag系はんだ接合部のパワーサイクル損傷挙動
2022年度	令和4年度	堀内涼太郎	茨城大学	ウェッジボンディングにおける接合界面形成過程
2022年度	令和4年度	植木竜佑	(株)クオルテック	深層学習を利用した非破壊のはんだクラック3次元測定手法の開発
2022年度	令和4年度	中村光希	日本アイ・ビー・エム(株)	銅電解析出を用いたフリップチップ実装におけるめっき形成の評価

※2021年・2022年はオンライン開催のためMate萌芽研究賞の名称にて授与